

张家港、太仓、滁州、四川、成都、重庆等焊锡膏

产品名称	张家港、太仓、滁州、四川、成都、重庆等焊锡膏
公司名称	苏州工业园区泰硕电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:TSP268 粘度:200 (Pa · S) 颗粒度:25 ~ 45 (um)
公司地址	苏州工业园区唯亭镇张泾工业小区D幢
联系电话	0512-86887698 13656202619

产品详情

型号	TSP268	粘度	200 (Pa · S)
颗粒度	25 ~ 45 (um)	品牌	TESA
规格	Sn96.5Ag3.0Cu0.5	合金组份	锡银铜
活性	强	类型	RSA
清洗角度	免清洗	熔点	217

泰硕的无铅锡膏由无铅锡低氧化度的球形焊料末组成，具有优越的环保性，体系中采用高性能触变剂，具有优越的溶解性和持续性，适用于细间距器件[qfp等]的贴装。1、优点 outstanding features
a：使用无铅合金 b：在连续印刷时可获得稳定之印刷性，影响粘度甚小。
c：在叉型模式可以获得绝佳之可印刷性。 d：在各类型之组件上均有良好的可焊性，适当的润湿性。
e：芯片侧极少发生锡球 f：适用于热风回流和 g: 在高温时可以获得优越的焊锡性 2、合金组成
a：sn96.5/ag3.0/cu0.5 217 b: sn99.3/cu0.7 227 c: sn95.5/ag3.9cu0.6 d: sn/ag/bi e: sn42/bi58 139 f: sn63/pb37 183
3、品质保证期 quality guarantee period 品质保证期为生产后六个月（在密封保存于10 以下）